

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 发行结果公告

**保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司**

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕954号）。发行人的股票简称为“晶合集成”，扩位简称为“晶合集成”，股票代码为“688249”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.86元/股。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票数量为501,533,789股，发行股份占公司发行后总股本的比例为25.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至576,763,789股，约占公司发行后总股本的比例为27.71%。

本次发行后公司总股本为2,006,135,157股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为2,081,365,157股。

本次发行初始战略配售数量为150,460,136股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。参与战略配售的投资者

承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 125,988,825 股，约占初始发行数量的 25.12%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股本的 21.84%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 24,471,311 股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 305,330,464 股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 81.30%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 67.73%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 70,214,500 股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 18.70%；网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 145,444,500 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 32.27%。

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 75,230,000 股，占本次初始发行股份数量 15.00%。

根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 1,160.60 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 37,554,500 股）从网下回拨至网上发行。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 267,775,964 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 59.40%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的 46.43%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 240,994,126 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 26,781,838 股；网上最终发行数量为 182,999,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.60%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的 31.73%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.10840977%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）结束。

具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

### （一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；

（3）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）；

（4）中金丰众 42 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 42 号”）、中金丰众 43 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 43 号”）、中金丰众 44 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 44 号”）、中金丰众 45 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金丰众 45 号”）（以下合称为“专项资产管理计划”）。

截至 2023 年 4 月 17 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）将在 2023 年 4 月 26 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占本次初 始发行数量的比例 (%)	获配金额(元)	限售期
1	北京集创北方科技股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长	25,176,233	5.02	499,999,987.38	12 个月

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占本次初 始发行数量的比例 (%)	获配金额(元)	限售期
2	芜湖瑞倍嘉企业管理 有限公司	期合作愿景的大型企 业或其下属企业	15,105,740	3.01	299,999,996.40	12个月
3	合肥鑫城国有资产经 营有限公司		10,070,493	2.01	199,999,990.98	12个月
4	思特威(上海)电子 科技股份有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
5	杰华特微电子股份有 限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
6	北京屹唐半导体科技 股份有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
7	上海新相微电子股份 有限公司		2,517,623	0.50	49,999,992.78	12个月
8	中国保险投资基金 (有限合伙)		具有长期投资意愿的 大型保险公司或其下 属企业、国家级大型投 资基金或其下属企业	35,246,727	7.03	699,999,998.22
9	中国中金财富证券有 限公司	保荐人相关子公司	10,030,676	2.00	199,209,225.36	24个月
10	中金丰众42号员工参 与科创板战略配售集 合资产管理计划	发行人的高级管理 人员与核心员工参与本 次战略配售设立的专 项资产管理计划	5,000,930	1.00	99,318,469.80	12个月
11	中金丰众43号员工参 与科创板战略配售集 合资产管理计划		5,160,971	1.03	102,496,884.06	12个月
12	中金丰众44号员工参 与科创板战略配售集 合资产管理计划		8,213,187	1.64	163,113,893.82	12个月
13	中金丰众45号员工参 与科创板战略配售集 合资产管理计划		1,913,376	0.38	37,999,647.36	12个月
	<b>合计</b>			<b>125,988,825</b>	<b>25.12</b>	<b>2,502,138,064.50</b>

## (二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：181,821,830股；
- 2、网上投资者缴款认购的金额：3,610,981,543.80元；
- 3、网上投资者放弃认购数量：1,177,170股；
- 4、网上投资者放弃认购金额：23,378,596.20元。

### （三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：267,775,964 股；
- 2、网下投资者缴款认购的金额：5,318,030,645.04 元；
- 3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
- 4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元。

## 二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，总计包销股份的数量为 1,177,170 股，包销金额为 23,378,596.20 元，包销股份的数量占超额配售启用后扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为 0.26%，包销股份的数量占超额配售启用后本次发行总量的比例约为 0.20%。

2023 年 4 月 26 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除超额配售股票募集的资金和承销保荐费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号），获授权的主承销商在发行人股票上市之日起 30 个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。保荐人（主承销商）承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起 30 个自然日内不出售其包销股份。

## 三、保荐人（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620567

发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2023年4月26日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）



发行人：合肥晶合集成电路股份有限公司

2023 年 4 月 26 日

（此页无正文，为《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2023年 4 月 26 日